

TG-AD66 超软导热硅胶片

Ultra Soft Thermal Pad

REACH Compliant

RoHS Compliant

UL Compliant

产品特性 Features

- 高导热特性
High thermal conductivity
- 低热阻抗
Low thermal impedance
- 绝缘性佳
Good electrical insulation

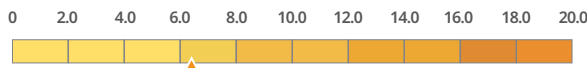
产品应用端 Applications

Best for high power applications

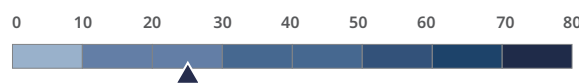
Electronic Components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datacom, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

产品物性 Properties

导热系数 Thermal Conductivity : 6.5 W/m·K

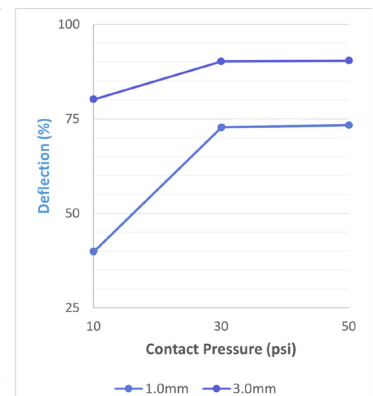
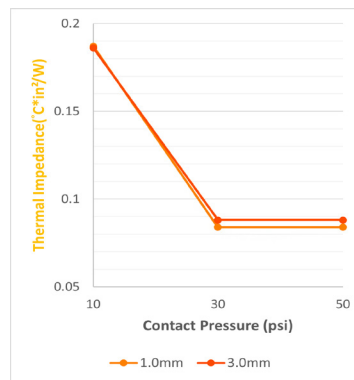


硬度 Hardness : 25 (Shore OO)



压力, 热阻抗, 变形量示意图

Contact Pressure, Thermal Impedance, and Deflection



Properties	Unit	TG-AD66	Tolerance	Test Method
导热系数 Thermal Conductivity	W/m·K	6.5	±10%	ASTM D5470 Modified
厚度 Thickness	mm	1.0~10.0	-	ASTM D374
	inch	0.039~0.394	-	ASTM D374
颜色 Color	-	绿 Green	-	Colorimeter CIE 1976
耐燃等级 Flame Rating	-	V-0	-	UL 94
耐电压 Dielectric Breakdown Voltage	KV/mm	≥4	-	ASTM D149
重量损失 Weight Loss	%	<1	-	ASTM E595 Modified
密度 Density	g/cm³	3.3	±10%	ASTM D792
工作温度 Operating Temperature	°C	-50~+150	-	-
体积阻抗 Volume Resistivity	Ohm-m	10 ¹²	±10%	ASTM D257
抗拉强度 Tensile Strength @T3.0mm	kgf/cm²	≥6	-	ASTM D412
延展率 Elongation	%	1	-	ASTM D412
标准规格 Standard Format	-	Sheet	-	-
硬度 Hardness	Shore OO	25	±10	ASTM D2240

※ 依选用厚度适用不同公差值 Different tolerances according to the selected thickness

※ 可依需求冲型裁切 Die-cut for different shapes

高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃园市桃园区大仁路 50 巷 33 号 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan

T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version19
20241210



注意：本技术数据表内的资讯是根据高柏团队的研究与测试得出的最佳数据。本技术数据表中列出的值仅代表典型值，并非对每一批生产的物料都进行测试。

所有规格如有变更，恕不另行通知；无影响产品功能之保护膜及离型纸，如非特殊要求，皆依高柏默认为准。由于各种可能的使用条件超出了我们的控制范围，因此我们提出的所有建议均不构成保证责任，用户应自行进行测试，以确定我们的产品在任何特定情况下的适用性。本产品的销售没有任何明示或暗示的说明，表示其适用于特定目的或其他用途的保证，但本产品应依据高柏与您确认的发票、报价、或订单，提供最标准的产品质量。我们不承担使用者如何延伸或改变此技术数据表中的资讯，使用者应承担所有风险。此外，本技术数据表中的资讯不包含任何内容解释与涉及产品材料的现有用途、未来专利冲突、工艺制造，与使用产品的建议。